

2019年11月28日

各 位

会社名 パナソニック株式会社
代表者名 代表取締役社長 津賀 一宏
(コード番号 6752 東証・名証第一部)
問合せ先 コーポレート戦略本部
財務・IR部長 中島 美憲
(TEL. 06-6908-1121)

半導体事業に関する会社分割(簡易吸収分割)のお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議により、当社グループの半導体事業を、台湾に本社を置く半導体企業であるWinbond Electronics Corporation傘下のNuvoton Technology Corporation(以下、「Nuvoton」)に譲渡(以下、「本件取引」)することに関連して、当社が保有する半導体事業関連の知的財産権および契約の一部等を、吸収分割(以下、「本吸収分割」)の方法により、当社100%出資の連結子会社であるパナソニック出資管理合同会社(以下、「PEMJ」)の100%出資連結子会社であるパナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社(以下、「PSCS」)に承継させることを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の100%間接出資の子会社との組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

本件取引についての詳細は、添付資料「半導体事業の譲渡について」をご参照ください。

記

1. 本件取引の背景および目的

当社の半導体事業は、過去数年来、AV分野から車載・産業分野へのシフトとともに、イメージセンサなどの「空間認識」技術と、バッテリーマネジメント用ICやリチウムイオン電池保護回路用MOSFETなどの「電池応用」技術を注力分野と位置付け、これらの分野にリソースを集中することで事業成長を目指してきました。

一方で、2014年4月に北陸工場(魚津・砺波・新井)の半導体ウエハ製造工程を、イスラエルの半導体ファウンドリ企業タワーセミコンダクター社との合併会社に移管しました。さらに同年6月にはシンガポール、インドネシアおよびマレーシアに保有していた半導体組立工場を、香港に本社を置くUTACマニュファクチャリングサービシーズ社へ譲渡しました。その後も国内外拠点の統廃合を行い、アセットライト化による事業リスクの低減を図り、競争力の強化に取り組んできました。

しかしながら、近年の競合他社の勢力拡大、注力事業への巨額投資、M&Aを通じた業界再編の進行等、半導体事業を取り巻く競争環境は熾烈を極めてきております。このような中、今後当該事業を成長拡大させるためには事業運営の強化と継続した投資が極めて重要となります。

かかる背景により今回、当社が蓄積してきた技術力、商品力を高く評価し、それらを最大限活用し、持続的な事業成長が期待できるNuvotonの下での事業運営が最善と判断し、本件取引を決定しました。

なお、本吸収分割は本件取引を行うための組織再編行為です。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

本吸収分割の承認にかかる取締役会決議	2019年11月28日
吸収分割契約書締結日	未定
吸収分割期日(効力発生日)	未定

(注)本吸収分割は、会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割に該当するため、吸収分割の承認に関する株主総会を開催しません。
吸収分割契約書締結日ならびに効力発生日は決定次第開示します。

(2) 本吸収分割の方式

当社を分割会社とし、PSCSを承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)です。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

PSCSは、本吸収分割に際して対価の割当てを行いません。

(4) 本吸収分割に係る新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済みの新株予約権について、本吸収分割による変更はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 分割承継会社が承継する権利義務

PSCSは、当社が保有する半導体事業関連の知的財産権および契約の一部ならびに半導体事業関連資産・負債の一部を承継します。

(7) 債務履行の見込み

PSCSが、本吸収分割後に負担すべき債務については、その履行の確実性に問題はないものと判断しています。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	分割会社(2019年9月30日現在)	承継会社(2019年9月30日現在)
(1)商号	パナソニック株式会社	パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社(PSCS)
(2)本店所在地	大阪府門真市大字門真 1006 番地	京都府長岡京市神足焼町1番地
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津賀 一宏	代表取締役社長 小山 一弘
(4)事業内容	電気・電子機器等の製造・販売	半導体および関連部品の開発・製造・販売
(5)資本金	258,867 百万円	400 百万円
(6)設立年月日	1935年12月15日	2014年3月10日
(7)発行済株式総数	2,453,326,997 株	8,000 株

(8)決算期	3月31日	3月31日
(9)大株主および 持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 7.93%	パナソニック出資管理合同会社(PEMJ) 100%※
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 7.15%	
	日本生命保険相互会社 2.96%	
	JP MORGAN CHASE BANK 385151 2.03%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口5) 1.96%	

(注) ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者5社から、2017年3月22日付で大量保有報告書が提出されています。当該報告書によれば、パナソニックに関して2017年3月15日現在の保有株券等の数及び株券等保有割合は、それぞれ122,710千株及び5.00%です。パナソニックは2019年9月末現在の実質所有株式数の確認ができなため、分割会社に係る「大株主及び持株比率」欄は、当社の株主名簿に基づいて記載しております。

※ 本件取引においては、承継会社の全株式を新たに設立するPEMJの完全子会社に株式譲渡により承継させた上で、当該完全子会社の全株式を、Nuvotonに譲渡する予定です。

(10) 分割会社(当社)の直前事業年度の財政状態および経営成績(連結)

決算期	2019年3月期
親会社の所有者に帰属する持分	1,913,513 百万円
資産合計	6,013,931 百万円
1株当たり親会社所有者 帰属持分	820 円 41 銭
売上高	8,002,733 百万円
営業利益	411,498 百万円
親会社の所有者に帰属する 当期純利益	284,149 百万円
基本的1株当たり親会社の所有者 に帰属する当期純利益	121 円 83 銭

(注) 1. 百万円未満の金額は四捨五入しています。
2. 国際財務報告基準(IFRS)に基づいて表示しています。
3. 当社は、自己株式120,473千株を保有しています(2019年9月30日現在)。

4. 本吸収分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

本吸収分割は、当社が保有する半導体事業関連の知的財産権および契約の一部ならびに半導体事業関連資産・負債の一部をPSCSに承継するものであり、事業部門の承継は行われません。

(2) 分割する事業部門の経営成績

(単位:億円)

	2019年3月期 部門実績(単体)(a)	2019年3月期 当社実績(連結)(b)	比率(a/b)
売上高	-	80,027	-

(注) 1. 億円未満の金額は四捨五入しています。
2. 分割する事業部門はないため、売上はありません。

(3) 分割する資産、負債の項目および金額(2019年3月31日現在)

(単位:億円)

資 産		負 債	
項 目	帳 簿 価 額	項 目	帳 簿 価 額
流 動 資 産	6	流 動 負 債	11
固 定 資 産	9	固 定 負 債	1
合 計	15	合 計	12

(注) 1. 億円未満の金額は四捨五入しています。

2. 実際に承継させる資産の金額は、上記金額に効力発生日までの増減が反映されたものとなります。

5. 本吸収分割後の状況

当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期について、いずれも本吸収分割による影響はありません。

6. 今後の見通し

本件取引による当社の2020年3月期連結業績予想に与える重要な影響はない見込みです。

(添付資料)「半導体事業の譲渡について」

以 上

<将来見通しに関するリスク情報>

本プレスリリースには、パナソニックグループの「将来予想に関する記述」に該当する情報が記載されています。本プレスリリースにおける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当しません。これら将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものであり、これには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受ける恐れがあります。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるパナソニックグループの将来における業績、経営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。パナソニックグループは、本プレスリリースの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆様におかれましては、金融商品取引法に基づく今後の提出書類およびその他の当社の行う開示をご参照下さい。

なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書等にも記載されていますのでご参照ください。

- ・米州、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向
- ・多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動
- ・ドル、ユーロ、人民元等の対円為替相場の過度な変動により外貨建てで取引される製品・サービスなどのコストおよび価格が影響を受ける可能性
- ・資金調達環境の変化等により、パナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性
- ・急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで投入することができない可能性
- ・他企業との提携または企業買収等で期待どおりの成果を上げられない、または予期しない損失を被る可能性
- ・パナソニックグループが他企業と提携・協調する事業の動向(BtoB(企業向け)分野における、依存度の高い特定の取引先からの企業努力を上回る価格下落圧力や製品需要の減少等の可能性を含む)
- ・多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持することができなくなる可能性
- ・製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性
- ・第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約
- ・諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等(直接・間接を問わない)
- ・法規制に起因した制約・費用・法的責任の発生または法令遵守のための内部統制が不十分である可能性
- ・パナソニックグループが保有する有価証券およびその他の金融資産の時価や有形固定資産、のれん、繰延税金資産などの非金融資産の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化
- ・ネットワークを介した不正アクセス等により、パナソニックグループシステムから顧客情報・機密情報が外部流出する、あるいはネットワーク接続製品に脆弱性が発見され、多大な対策費用負担が生じる可能性
- ・地震等自然災害の発生、感染症の世界的流行、サプライチェーンの寸断、その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素

2019年11月28日

半導体事業の譲渡について

パナソニック株式会社(以下、「当社」)は本日付の取締役会決議により、当社100%出資の連結子会社であるパナソニック出資管理合同会社(以下、「PEMJ」)の100%出資連結子会社であるパナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社(以下、「PSCS」)を中心に運営している半導体事業を、台湾に本社を置く半導体企業であるWinbond Electronics Corporation傘下のNuvoton Technology Corporation(以下、「Nuvoton」)に譲渡(以下、「本件譲渡」)すること、ならびに同社との間で株式資産譲渡契約(以下、「本契約」)を締結することを決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。

1. 背景および目的

当社の半導体事業は、過去数年来、AV分野から車載・産業分野へのシフトとともに、イメージセンサなどの「空間認識」技術と、バッテリーマネジメント用ICやリチウムイオン電池保護回路用MOSFETなどの「電池応用」技術を注力分野と位置付け、これらの分野にリソースを集中することで事業成長を目指してきました。

一方で、2014年4月に北陸工場(魚津・砺波・新井)の半導体ウエハ製造工程を、イスラエルの半導体ファウンドリ企業タワーセミコンダクター社との合併会社に移管しました。さらに同年6月にはシンガポール、インドネシアおよびマレーシアに保有していた半導体組立工場を、香港に本社を置くUTACマニュファクチュアリングサービシーズ社(以下、「UTAC社」)へ譲渡しました。その後も国内外拠点の統廃合を行い、アセットライト化による事業リスクの低減を図り、競争力の強化に取り組んできました。

しかしながら、近年の競合他社の勢力拡大、注力事業への巨額投資、M&Aを通じた業界再編の進行等、半導体事業を取り巻く競争環境は熾烈を極めてきております。このような中、今後当該事業を成長拡大させるためには事業運営の強化と継続した投資が極めて重要となります。

かかる背景により今回、当社が蓄積してきた技術力、商品力を高く評価し、それらを最大限活用し、持続的な事業成長が期待できるNuvotonの下での事業運営が最善と判断し、本件譲渡を決定しました。

2. 本件譲渡について

(1)譲渡前事業再編:当社は本件譲渡の直前に次の通り半導体事業の再編を行います。

- ①PEMJの完全子会社であるパナソニック デバイスシステムテクノ株式会社(以下、「PIDST」)、パナソニック デバイスエンジニアリング株式会社(以下、「PIDE」)の全

株式を、会社分割によりPSCSに承継させます。

- ②当社および当社子会社が保有する半導体事業関連の知的財産権および契約の一部、ならびに当社が保有する半導体事業関連資産・負債の一部を、会社分割または資産譲渡によりPSCSに承継させます。
- ③PEMJが保有するPSCSの全株式を、新たに設立するPEMJの完全子会社(以下、「PSCS持株会社」)に株式譲渡により承継させます。
- ④PSCSの半導体関連部品(リードフレーム)事業を会社分割により新たに設立するPEMJの完全子会社に承継させます。

(2)本件譲渡の内容:上記「譲渡前事業再編」を前提に、2020年6月1日を効力発生日(予定)として、次の通り本件譲渡を実施します。

- ①PEMJは譲渡前事業再編後のPSCS持株会社の全株式をNuvotonに譲渡します。
- ②当社が子会社を通じて保有しているシンガポール法人パナソニック アジアパシフィック株式会社(以下、「PA」)において、半導体の開発・販売事業を担当する社内カンパニーであるパナソニック デバイスセミコンダクターアジア(以下、「PIDSCA」)の事業を、Nuvotonのシンガポール法人に譲渡します。
- ③パナソニック セミコンダクター蘇州有限会社(以下、「PSCSZ」)の半導体事業に係る設備・在庫等をNuvotonの中国法人に譲渡します。

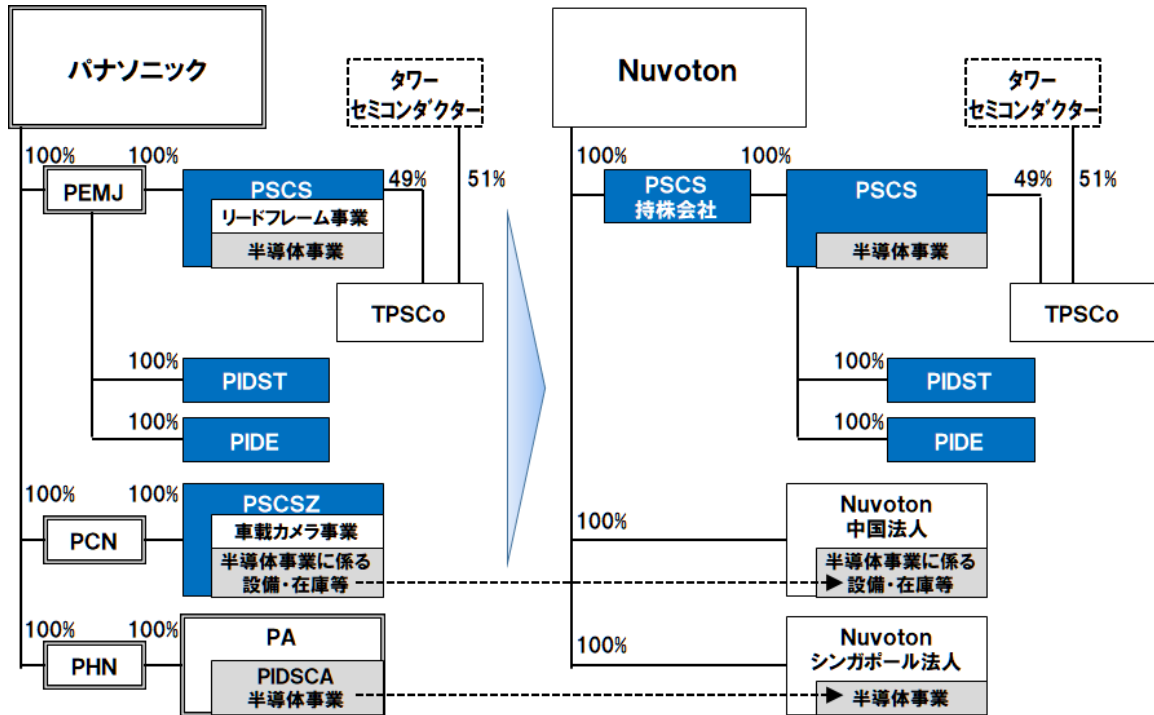
3. その他

本契約は、各国・地域の競争法当局その他政府機関の承認取得を前提としております。また、譲渡前事業再編を含む本件譲渡の実行予定日は、当該承認取得およびその他の許認可等に関する手続きにかかる期間を踏まえ大きく異なる可能性があります。

以上

<ご参考>

【本件譲渡による資本関係の変化】



- ・PCN: パナソニック チャイナ
- ・PHN: パナソニック ホールディングオランダ
- ・TPSCo: パナソニック・タワージャズ セミコンダクター

【当社半導体事業の沿革】

1957年	・松下電子工業(フィリップス社との合併会社)高槻工場において半導体生産開始
1968年	・長岡工場(京都府長岡京市、現 PSCS本社所在地)稼働。シリコンランジスタ/バイポーラIC量産開始
1970年	・MOS LSI量産開始
1993年	・フィリップス社との合併を解消し、松下電器産業(現 パナソニック)の100%子会社に
2001年	・松下電器産業が松下電子工業を吸収合併
2014年	・タワーセミコンダクター社と拡散工程の合併会社設立 ・UTAC社へマレーシア、シンガポール、インドネシアの組立工場を譲渡
2015年	・ソシオネクスト社へシステムLSI事業を移管
2019年	・ディスクリート半導体事業をローム社へ譲渡(予定)

【パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社の概要】

名称	パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社
所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地
代表者	代表取締役社長: 小山 一弘
事業内容	半導体および関連部品の開発、製造、販売
設立	2014年3月10日
資本金・出資	4億円 パナソニック出資管理合同会社100%

【パナソニック デバイスシステムテクノ株式会社の概要】

名称	パナソニック デバイスシステムテクノ株式会社
所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地
代表者	代表取締役: 中澤 省吾
事業内容	半導体関連の設計、開発
設立	1997年1月10日
資本金・出資	2億円 パナソニック出資管理合同会社100%

【パナソニック デバイスエンジニアリング株式会社の概要】

名称	パナソニック デバイスエンジニアリング株式会社
所在地	富山県魚津市東山800番地
代表者	取締役社長：梶原 大平
事業内容	半導体関連の技術業務請負
設立	2000年3月1日
資本金・出資	2億円 パナソニック出資管理合同会社100%

【パナソニック デバイスセミコンダクターアジアの概要】

名称	パナソニック デバイスセミコンダクターアジア 英文名：Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia
所在地	シンガポール
代表者	社長：下茂 智博
事業内容	半導体の開発、販売
設立	1978年12月1日
備考	パナソニック アジアパシフィック株式会社の社内カンパニー

【パナソニック セミコンダクター蘇州有限会社の概要】

名称	パナソニック セミコンダクター蘇州有限会社 中文名：蘇州松下半導体有限公司
所在地	中国 江蘇省 蘇州市高新区鹿山路666号
代表者	董事長：小山 一弘
事業内容	半導体の製造、販売 車載カメラの製造
設立	2001年12月29日
資本金・出資	95億円 パナソニック チャイナ有限会社100%

【Winbondの概要】

名称	Winbond Electronics Corporation 華邦電子股份有限公司
所在地	台中市42881大雅區中部科學園區科雅一路8號
代表者	董事長: アーサー・チャオ(焦佑鈞)
事業内容	スペシャルティ DRAM、コードストレージ用フラッシュメモリ IC の製品設計、研究開発、ウエハ製造
設立	1987年9月29日
資本金・出資	398億台湾ドル Walsin Lihwa Corporation 22.01%, Chin Xin Investment 5.0%

【Nuvotonの概要】

名称	Nuvoton Technology Corporation 新唐科技股份有限公司
所在地	新竹市東区新竹科学工業園區研新三路4号
代表者	社長: ショーン・タイ(戴尚義)
事業内容	ロジック集積回路(「IC」)の研究、設計、開発、製造、販売及び6インチウエハの製造、試験、OEM
設立	2008年4月9日
資本金・出資	73億5,800万台湾ドル Winbond Electronics Corporation 61.55%